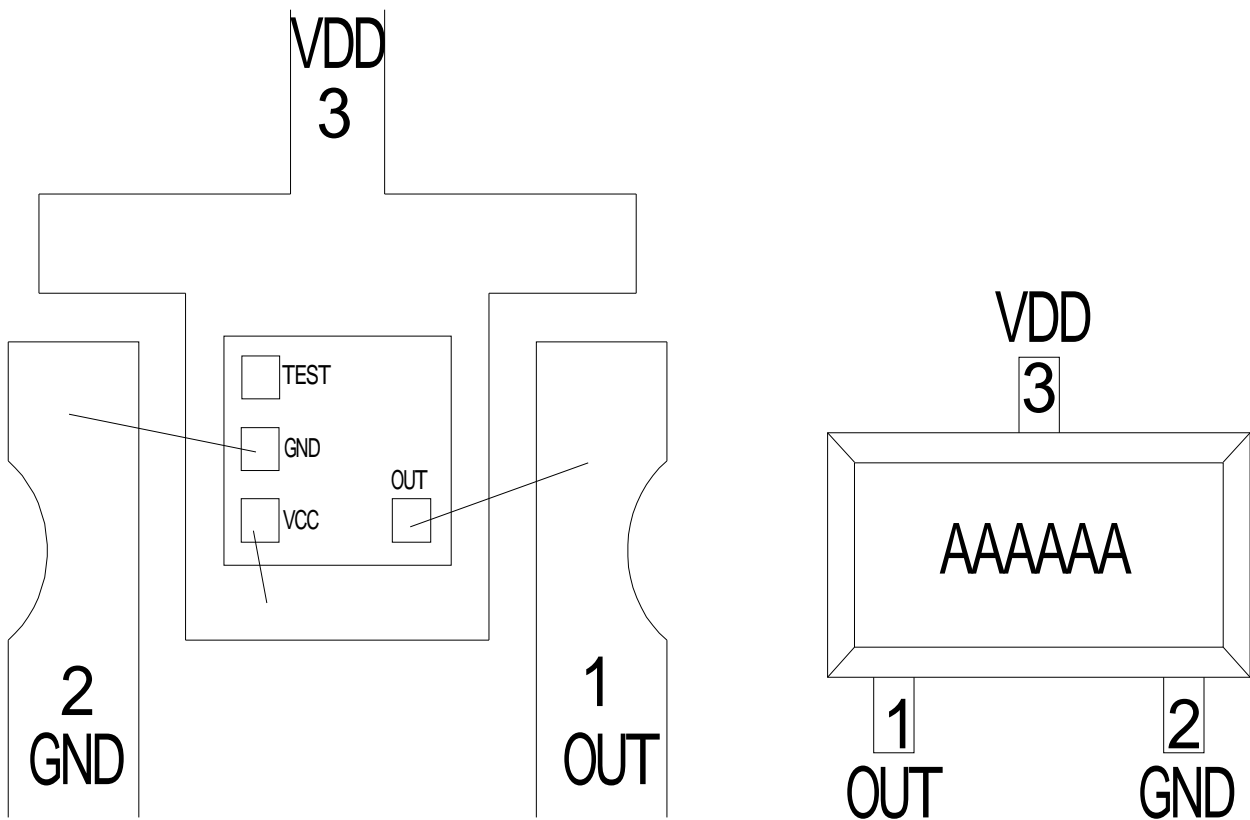


芯片名称		框架基底	
封装形式	SOT23-3	芯片尺寸 (um)	725 X 560
MAKE(LOGO)	DL8863	粘合方式	导电胶
产品批号	XXXXX	线规格 (um)	CU 25um



客户回签: _____

	核准	审核	工程师	制图
BY				
DATE				